TASNEE التصنيع

Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE / LDPE)

TASNEE LD 1925F

Köpük ekstrüzyon proseslerinde, kusursuz ve homojen hücre dağılımı sağlamak için tasarlanmış özel katkılı polietilen reçine.



NotebookLM

İdeal erime ve akışkanlık dengesiyle standart ekstrüzyon hatlarına tam uyum.

Akışkanlık (MFI/MFR)

1.90

g/10dk

190°C / 2.16 kg | ISO 1133

Yoğunluk

0.925

g/cm³

ISO 1183

Erime & Yumuşama

111°C

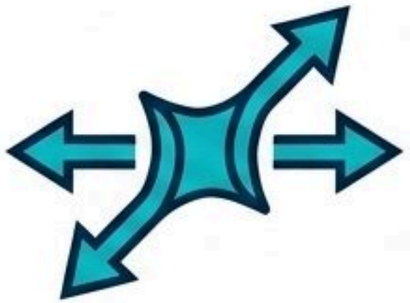
(Erime)

94°C (Vicat Yumuşama)

ISO 3146 / ISO 306

NotebookLM

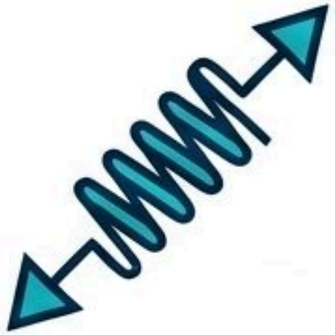
Köpük ürünler için özel olarak optimize edilmiş üstün mekanik esneklik ve kopma dayanımı.



Kopma Uzaması

250% (MD) /
600% (TD)

ISO 527
(Yüksek esneme kapasitesi)



Çekme Modülü

260 MPa

ISO 527



Çekme Dayanımı

26 MPa (MD)/
18 MPa (TD)

ISO 527



Darbe Dayanımı

110 g

ASTM D 1709 (Dart Drop)

**Değerler 180°C erime sıcaklığında üretilmiş ve 2:1 şişirme oranına sahip 50 µm kalınlığındaki film üzerinden ölçülmüştür.*

NotebookLM

Çapraz bağlı (crosslinked) ve bağsız köpük uygulamalarının temel reçinesi.



Ambalaj Köpükleri

Darbe emici, güvenli ve esnek koruma çözümleri.



Isı ve Ses Yalıtımı

İnşaat ve endüstriyel sistemler için izolasyon panelleri.



Otomotiv Uygulamaları

Araç içi titreşim sönümleyici ve yalıtım parçaları.



Bant Uygulamaları

Endüstriyel ve ticari kendinden yapışkanlı bant altlıkları.

NotebookLM

Üniform hücre yapısı ve tutarlı köpük kalitesi hedeflediğinizde idealdir.

Homojen Hücre Dağılımı Gerektiğinde: İçerdiği özel katkı paketi sayesinde ekstrüzyon sırasında hücre boyutunu ve mimarisini kusursuz şekilde kontrol altında tutmak istiyorsanız.

Standart Ekstrüzyon Prosesi Kullanıyorsanız: Tüm geleneksel LDPE köpük ekstrüzyon ekipmanlarında değişiklik yapmadan, yüksek işlenebilirlik arıyorsanız.

Yüksek Esneklik Arandığında: %600'e varan enine (TD) kopma uzaması ve üstün darbe emilimi gerektiren ambalaj/yalıtım ürünleri üreteceksenız.

NotebookLM

Ürün esnek köpük ekstrüzyonu için optimize edilmiştir; limitleri doğru bilinmelidir.

❌ **Yüksek Sıcaklık Direnci Gerektiğinde:** Vicat yumuşama noktası 94°C, erime noktası 111°C'dir. Yüksek ısıya doğrudan maruz kalacak son ürünler için uygun değildir.

❌ **Yüksek Rijitlik ve Sertlik İstendiğinde:** Çekme modülü 260 MPa'dır. Sert, esnemeyen, yapısal veya ağır yük taşıyan plastik parçalar için tasarlanmamıştır.

❌ **Uzun Süreli Stoklama Yapılacaksa:** Ürünün maksimum performansı için teslimattan itibaren en geç 6 ay içinde işlenmesi gerekmektedir. Uzun bekleme süreleri kaliteyi düşürebilir.

NotebookLM

Optimum kalite için doğru sıcaklıkta işleyin ve çevresel faktörlerden koruyun.



Proses Şartları (İşleme)

- **Erime Sıcaklığı:** 160°C – 200°C arası önerilir.
- **İş Güvenliği ve Havalandırma:** Eriyik polimer buharlaşma yapabilir; göz/deri temasından kaçınılmalı ve çalışma alanı çok iyi havalandırılmalıdır.

Depolama ve Raf Ömrü



Direkt güneş ışığından ve 40°C üzeri sıcaklıklardan koruyun. UV radyasyonu ve aşırı ısı bozulmaya yol açar.



Teslimattan sonraki 6 ay içinde tüketin. İlk giren ilk çıkar (FIFO) kuralını uygulayın.



Ortamdaki büyük sıcaklık dalgalanmaları ambalaj içi yoğuşmaya sebep olabilir. Gerekirse kullanmadan önce kurutun.

NotebookLM

TASNEE التصنيع

TASNEE LD 1925F, sahip olduğu özel katkı paketi ve optimize edilmiş molekül yapısıyla; ısı ve ses yalıtımı ile ambalaj köpüğü üretiminde kusursuz, kontrol edilebilir bir hücre mimarisi sunar.

Sürekli Kalite

Kolay İşlenebilirlik

Mükemmel Köpük Yapısı

Gıdayla temas eden özel son kullanım uygulamaları ve yerel mevzuat uygunluğu (Food Contact) için lütfen bölgenizdeki TASNEE temsilcisiyle iletişime geçiniz.

NotebookLM